

第5回 有機/無機接合研究委員会 プログラム

日時:2019年 11月 11日(月) 13:00~16:50

場所:日本橋ライフサイエンスビルディング 912+913 会議室 (東京都中央区)

時間	題目	講演者
13:00~ 13:15	委員会議事	
	司会 森 三樹(東京大学)	
13:15~ 14:00	『金属-樹脂界面の分析』 (45分)	○山本 麻矢、田中 大策、藤村 修平 (株)三井化学分析センター)
14:00~ 14:45	『透過電子顕微鏡によるナノスケール熱伝導性 評価法の開発』 (45分)	○川本 直幸*1、掛札 洋平*2、 山田 勇*3、三留 正則*1、板東 義雄*1、 森 孝雄*1、ゴルバーク ドミトリ*1 (*1 国立研究開発法人物質・材料研究機構 *2 (株)ピコサーム *3 山田 R&D サポート 事業所)
14:45~ 15:00	休憩	
	司会 朝桐 智((株)東芝)	
15:00~ 15:15	有機/無機接合材料の評価法規格 (15分)	○小山 真司(群馬大学)
15:15~ 15:20	群馬大学重点支援プロジェクト「発展型 マルチマテリアル実装プラットフォームの 構築」紹介	○荘司 郁夫(群馬大学)
15:20~ 16:05	『ナノ加工技術を用いた高感度バイオセンサ の創製』 (45分)	○曾根 逸人(群馬大学)
16:05~ 16:50	『ポリマーMEMSの微細加工法とその IoT応用』 (45分)	○鈴木 孝明(群馬大学)

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。